

上海新阳半导体材料股份有限公司
关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
(董事会审议稿)

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号》的规定，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至 2015 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]902 号文《关于核准上海新阳半导体材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 6 月 20 日由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行方式相结合的方式发行人民币普通股(A 股)股票 2,150 万股，发行价格为每股人民币 11.07 元，募集资金总额为人民币 23,800.50 万元，扣除各项发行费用人民币 2,347.98 万元后，实际募集资金净额为人民币 21,452.52 万元，于 2011 年 6 月存入公司募集资金专用账户中。

上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具“会验字[2011]4377 号《验资报告》”验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：

单位：人民币万元					
序号	项目名称	募集资金 年初余额	本年实际 使用金额	超募资金 划转金额	募集资金 年末余额
1	半导体封装化学材料技术改造项目	210.89	80.39	-	130.5
2	半导体封装表面处理设备技术改造项目	32.58	32.51	-	0.07
3	技术中心改造项目	20.62	20.62	-	-
4	超募资金	-	-	-	-
	合计	264.09	133.52	-	130.57

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、投资项目变更、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。本公司与保荐机构宏源证券股份有限公司、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》及其补充协议。

(二)募集资金在各银行账户的存储及变更情况

公司为本次募集资金开设了四个专项账户，分别为中国建设银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“建行松江支行”）、上海农村商业银行小昆山支行（以下简称“农商行小昆山支行”）、上海银行股份有限公司松江支行（以下简称“上海银行松江支行”）、中国民生银行上海松江支行（以下简称“民生银行松江支行”），2013年8月15日，根据第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议审议通过《关于变更“半导体封装化学材料技术改造项目”募集资金专户的议案》，同意注销原中国建设银行股份有限公司上海松江支行募集资金专用账户，账号为 31001937716059001268，同时在上海银行股份有限公司松江支行开设新的募集资金专用账户，账号为 319826-03002149795。公司已连同保荐机构宏源证券股份有限公司与上海银行签署募集资金三方监管协议并发表 2013-041 公告。2014年2月20日，根据第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议审议通过《关于变更“半导体封装表面处理设备技术改造项目”募集资金专户的议案》，同意注销原上海农村商业银行小昆山支行募集资金专用账户，账号为 32734208100000641，同时在上海浦东发展银行股份有限公司松江支行开设新的募集资金专用账户，账号为 98080155300002351。公司已连同保荐机构宏源证券股份有限公司与上海银行签署募集资金三方监管协议并发表 2014-008 公告。

截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	开户银行	账号	期末余额
1	半导体封装化学材料 技术改造项目 小计	上海银行松江支行	319826-03002149795	1,346,098.54 1,346,098.54
2	半导体封装表面处理 设备技术改造项目 小计	浦发松江支行	98080155300002351	0.00 0.00
3	技术中心改造项目 小计	上海银行松江支行	319826-03001606416	0.00 0.00
4	超募资金 小计 合计	中国民生银行上海松江 支行	0227014180001832	0.00 0.00 1,346,098.54

2015 年 7 月公司注销了募集资金半导体封装表面处理设备技术改造项目、技术中心改造项目、超募资金的三个募集资金专用账户。

上述募集资金期末余额 1,305,747.87 元，加上募集资金累计利息收入 14,988,036.57 元，扣除银行手续费支出 5,972.09 元、投入上海新昇半导体科技有限公司用于 300 毫米半导体硅片项目的利息收入 14,926,300.71 元、销户费用 15,413.10 元后的余额为 1,346,098.54 元，与银行专户存款余额一致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（详见附件 1）所示。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更事项。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司于 2011 年 8 月 17 日经华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具会审字(2011)第 4477 号鉴证报告核准，以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金 1,332.05 万元。

(四)节余募集资金使用情况

上述三个募集资金投资项目结项后，节余募集资金合计 5,747.63 万元，占公司首次公开发行股票募集资金净额的 26.79%。经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司将上述节余募集资金及利息收入全部作为注册资本金投入上海新昇半导体科技有限公司，用于 300 毫米半导体硅片项目的建设。

(五)超募资金使用情况

公司首次公开发行的超募资金净额为 3,952.53 万元。

经公司 2012 年 8 月 15 日召开的第一届董事会第二十一次会议决议，同意将超募资金中的人民币 790.00 万元永久补充公司流动资金。公司监事、独立董事以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。

经公司 2014 年 2 月 19 日召开的第二届董事会第十一次会议决议，同意将超募资金中的人民币 312.86 万元（51 万美元）作为注册资本金投入公司的控股子公司上海新阳海斯高科技材料有限公司。

2014 年 8 月 13 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司将其节余超募资金及利息收入 3,204.48 万元全部作为注册资本金投入上海新昇半导体科技有限公司，用于 300 毫米半导体硅片项目的建设。

(六)募集资金使用的其他情况

本年度无募集资金其他使用事项。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格遵守深圳证券交易所《募集资金管理细则》和公司制定的《募集资金管理办法》等相关规定，规范管理和使用募集资金，并及时对外披露，不存在管理和使用违规情况。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2016 年 4 月 19 日

附件：募集资金使用情况对照表

附件

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			21,452.52		本年度投入募集资金总额			133.52		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			22,814.57		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
半导体封装化学材料技术改造项目	否	11,201.03	11,201.03	80.39	9,019.24	80.52%	2014-06-30	546.18	否	否
半导体封装表面处理设备技术改造项目	否	3,311.39	3,311.39	32.51	2,919.12	88.15%	2014-06-30	-352.03	否	否
技术中心改造项目	否	2,987.57	2,987.57	20.62	775.43	25.96%	2014-06-30	-	否	否
300mm 半导体硅片项目	否	—	—	-	5,793.44	—	—	—	否	否
承诺投资项目小计	—	17,499.99	17,499.99	133.52	18,507.23	—	—	194.15	—	—
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
补充流动资金(如有)	—	—	—	—	790.00	—	—	—	—	—
300mm 半导体硅片项目	—	—	—	-	3,204.48	—	—	-89.28	—	—
新阳海斯注册资本	—	—	—	-	312.86	—	—	-91.86	—	—
超募资金投向小计	—	—	—	-	4,307.34	—	—	-181.14	—	—
合计	—	17,499.99	17,499.99	133.52	22,814.57	—	—	13.01	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“半导体封装化学材料技术改造项目”和“半导体封装表面处理设备技术改造项目”已于 2014 年 6 月 30 日建设完成，由于产能尚未完全释放，未达到预期经济效益。“技术中心技术改造项目”已于 2014 年 6 月 30 日建设完成并投入使用，本项目不产生直接经济效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

超募资金的金 额、用途及使 用进展情况	经公司 2012 年 8 月 17 日召开的第一届董事会第二十一次会议决议，同意将超募资金中的人民币 790.00 万元补充公司流动资金。经公司 2014 年 2 月 19 日召开的第二届董事会第十一次会议决议，同意将超募资金中的人民币 312.86 万元（51 万美元）作为注册资本金投入公司的控股子公司上海新阳海斯高科技材料有限公司。经公司 2014 年 8 月 13 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，同意将节余超募资金及利息收入 3,204.48 万元全部作为注册资本金投入上海新昇半导体科技有限公司，用于 300 毫米半导体硅片项目的建设。
募集资金投资 项目实施地点 变更情况	不适用
募集资金投资 项目实施方式 调整情况	不适用
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	公司于 2011 年 8 月 17 日经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具会审字（2011）第 4477 号鉴证报告核准，以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金 1,332.05 万元。
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况	不适用
项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因	“半导体封装化学材料技术改造项目”募集资金专户节余资金 2,705.98 万元（含利息净收入和应付未付金额）。节余原因如下：1、由于本项目与公司承担的国家 02 科技重大专项“65-45nm 芯片铜互连超高纯电镀液及添加剂研发和产业化”项目的部分建设内容重合，部分投资使用国家专项拨款，本项目同时获得国家技改项目扶持资金，在一定程度上节约了项目投入；2、项目执行过程中，公司充分发挥自身技术优势，利用自身生产工艺方面积累的丰富经验，通过招标等手段严控成本，也一定程度节约了项目投入。“半导体封装表面处理设备技术改造项目”募集资金专户节余资金 603.62 万元（含利息净收入和应付未付金额）。节余原因如下：由于近年来国内外经济形势发生了复杂的变化，半导体行业的持续低迷对专用设备市场产生了一定不利影响，公司因此适当调整了对表面处理设备技改项目的投入，同时，公司通过充分发挥自身技术优势，利用自身生产工艺方面积累的丰富经验，严控成本，节约投入，一定程度节约了项目投入。“技术中心技术改造项目”募集资金专户节余资金 2,438.03 万元（含利息净收入和应付未付金额）。节余原因如下：1、由于本项目与公司承担的国家 02 科技重大专项“65-45nm 芯片铜互连超高纯电镀液及添加剂研发和产业化”项目的部分建设内容重合，部分投资使用国家专项拨款，在一定程度上节约了项目投入；2、项目执行过程中，公司根据研发项目的实际需要，调整了研发方式和部分研发设备的购置计划，也一定程度节约了项目投入。
尚未使用的募 集资金用途及 去向	截止 2015 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金存放在上海银行松江支行。主要为“半导体封装化学材料技术改造项目”尚未支付的工程和设备质保金。
募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况	无。